

成都超纯应用材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“超纯应材”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（深证上〔2026〕552号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行股票承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》等相关规定。

本次发行价格65.99元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为36.38倍，低于中证指数有限公司2026年7月27日（T-4日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率70.62倍；低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率78.79倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面，具体内容如下：

- 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
- 2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于66.99元/股（不含66.99元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为66.99元/股、拟申购数量低于190.00万股（不含190.00万股）的配售对象全部剔除。以上过程共剔除402个配售对象，剔除的拟申购总量为178,800万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和5,964,360.00万股的2.9978%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为65.99元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2026年7月31日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年7月31日（T日），其中网下申购时间为09:30–15:00，网上申购时间为09:15–11:30、13:00–15:00。

4、发行人与主承销商协商确定的发行价格为65.99元/股，本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即华泰超纯股份家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“超纯应材员工资管计划”）和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，超纯应材员工资管计划最终战略配售股份数量为2,546,000股，约占本次发行数量的10.00%，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为4,546,140股，约占本次发行数量的17.85%。

本次发行初始战略配售数量为763.8461万股，约占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量为709.2140万股，约占本次发行数量的27.85%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额54.6321万股将回拨至网下发行。

5、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

成都超纯应用材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

网上申购日同为2026年7月31日（T日），其中网下申购时间为09:30–15:00，网上申购时间为09:15–11:30、13:00–15:00。

4、发行人与主承销商协商确定的发行价格为65.99元/股，本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即华泰超纯股份家园1号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“超纯应材员工资管计划”）和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，超纯应材员工资管计划最终战略配售股份数量为2,546,000股，约占本次发行数量的10.00%，其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为4,546,140股，约占本次发行数量的17.85%。

本次发行初始战略配售数量为763.8461万股，约占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量为709.2140万股，约占本次发行数量的27.85%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额546,321股将回拨至网下发行。

5、本次发行价格为65.99元/股，此价格对应的市盈率为：（1）27.28倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）24.75倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）36.38倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（4）33.00倍（每股收益按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

6、本次发行价格为65.99元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754–2017），发行人属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2026年7月27日（T–4日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为70.62倍。

截至2026年7月27日（T–4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，超纯应材员工资管计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

7、发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2026年7月31日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2026年8月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象当日获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后，应根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年8月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。

9、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价（元/股）	2025年扣非前EPS（元/股）	2025年扣非后EPS（元/股）	对应的静态市盈率—扣非前（2025年）	对应的静态市盈率—扣非后（2025年）
301611.SZ	珂玛科技	100.10	0.6630	0.6606	150.97	151.54
688605.SH	先锋精科	72.45	0.9334	0.9195	77.62	78.79
688409.SH	富创精密	199.00	-0.0281	-0.1689	-	-
688797.SH	臻宝科技	370.01	1.4549	1.4232	254.32	259.98
平均值（剔除异常值）					77.62	78.79

资料来源：Wind资讯，数据截至2026年7月27日（T–4日）

注1：2025年扣非前/后EPS计算口径：2025年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T–4日总股本；

注2：计算静态市盈率算术平均值时，市盈率≥100视为极值，均予以剔除；

注3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

本次发行价格65.99元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为36.38倍，低于中证指数有限公司2026年7月27日（T–4日）发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率70.62倍，低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率78.79倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本次发行定价合理性说明如下：

①半导体设备及零部件行业景气度持续上行，国产替代空间广阔，公司作为本土头部企业将持续受益

我国半导体设备及零部件市场正处于下游需求旺盛增长与国产替代加速推进的双重驱动期。在全球AI算力需求爆发、先进制程持续迭代、国内晶圆厂大规模扩产的背景下，半导体设备资本开支保持高位运行，直接拉动对设备零部件尤其是特殊涂层零部件的需求。根据弗若斯特沙利文的研究报告，2024年中国大陆半导体设备特殊涂层零部件市场持续扩容，但整体国产化率仍处于较低水平，约为7.1%，预计至2029年将提升至约12.4%，本土企业成长空间巨大。从半导体设备整体来看，根据华泰证券研究所数据，2025年国内半导体设备国产化率预计为23%，2026年预计进一步提升至29%，国产设备厂商的加速崛起为本土零部件供应商打开了明确的配套窗口。

在此趋势下，具备先进制程零部件供应能力的头部企业将获得更大的成长弹性——根据弗若斯特沙利文报告，发行人2024年在半导体设备特殊涂层零部件本土企业中的市场份额排名第一，在中国大陆市场整体份额为5.7%。

2023至2025年，发行人营业收入分别为16,905.00万元、25,687.80万元和49,573.87万元，年均复合增长率达71.25%，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为6,642.45万元、8,551.46万元和20,368.21万元，年均复合增长率达75.11%，经营业绩随行业景气上行和国产替代提速实

交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

11、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅读2026年7月30日（T–1日）公告的《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1、本次发行价格为65.99元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754–2017），公司主营业务所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至2026年7月27日（T–4日），中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为70.62倍。

截至2026年7月27日（T–4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价（元/股）	2025年扣非前EPS（元/股）	2025年扣非后EPS（元/股）	对应的静态市盈率—扣非前（2025年）	对应的静态市盈率—扣非后（2025年）
301611.SZ	珂玛科技	100.10	0.6630	0.6606	150.97	151.54
688605.SH	先锋精科	72.45	0.9334	0.9195	77.62	78.79
688409.SH	富创精密	199.00	-0.0281	-0.1689	-	-
688797.SH	臻宝科技	370.01	1.4549	1.4232	254.32	259.98
平均值（剔除异常值）					77.62	78.79

资料来源：Wind资讯，数据截至2026年7月27日（T–4日）

注1：2025年扣非前/后EPS计算口径：2025年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T–4日总股本；

注2：计算静态市盈率算术平均值时，市盈率≥100视为极值，均予以剔除；

注3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。

（下转A14版）

现高速增长。随着AI算力驱动先进制程产能持续扩张，中芯国际14nm/7nm及更先进产线、长江存储及长鑫存储等先进存储产线迭代升级，对特殊涂层零部件的需求将保持旺盛态势，发行人的成长具备坚实的行业基本盘支撑。

②公司聚焦特殊涂层核心技术自主研发，构建了“三位一体”的高壁垒技术护城河。发行人自2005年成立以来，始终以自主研发为核心驱动力，深耕特殊涂层工艺及其关联技术和材料领域，构建了覆盖半导体设备特殊涂层零部件的完整技术体系。发行人系国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家重点研发计划课题承担单位及四川省企业技术中心，依托长期技术积累，形成了特殊涂层工艺及其关联技术、特殊涂层材料及陶瓷材料制备技术、生产装备自主化研制技术三大核心技术矩阵，三者高度协同、相互依存，单独掌握其中一项或两项均难以满足先进制程半导体设备需求，构成“三位一体”的高壁垒技术护城河。

在特殊涂层工艺端，发行人掌握稳定量产的高难度物理气相沉积（PVD）工艺及高致密等离子喷涂（HDPS）工艺，其中PVD工艺难度极高，属国内极少数掌握的涂层技术——除发行人外，国内半导体零部件厂商尚未掌握稳定量产的PVD工艺；海外厂商如日本TOCALO出于保密需求与政策限制，即使在中国大陆建立工厂也未引入PVD工艺，仅在其本土生产。与KoMiCo等海外竞争对手官网公开的技术指标对比，发行人特殊涂层的孔隙率不亚于国外领先竞争对手，膜厚、结合强度等关键指标具有竞争优势。在先进制程应用端，发行人开发的介质窗、喷淋头等蚀刻设备核心零部件已通过5nm及以下制程工艺验证，成为国内极少数实现量产的企业，技术指标达到国际和国内先进制程晶圆厂要求，并成功导入多家国产半导体设备龙头供应链体系；重要客户A、客户B的等离子体蚀刻设备已应用于国际一线客户的5纳米、3纳米及更先进一代集成电路加工制造生产线。由客户A、客户B、鲁汶仪器等头部客户出具的技术及应用证明表明，发行人的特殊涂层零部件产品在国际领先的先进制程蚀刻设备上大规模应用，等离子体耐受性、温度冲击性、超细颗粒污染等关键性能取得突破，孔隙率、表面粗糙度、硬度、膜层厚度等关键技术参数达到国际领先水平。

在研发人才与创新机制方面，发行人截至报告期末拥有研发人员43人，占员工总数的12.08%，核心技术人员柴杰、柴林长期深耕特殊涂层领域，研发方向持续稳定。发行人与四川大学、北京航空航天大学共同承担国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”专项课题“透明陶瓷制造技术及装备”。此外，发行人对未以专利形式公开的大量核心工艺参数、配方、材料改性方法以专有技术实施严密保护，建立了权限分级、物理隔离、分段管理、协议约束等系统化保密体系，确保技术成果不外溢。在半导体零部件领域严苛的认证体系和发行人持续迭代的技术壁垒双重保护下，竞争者短期内突破和替代发行人的可能性较低。

③公司与下游头部客户深度绑定十余年，客户认证壁垒和产业生态协同形成长期护城河

发行人与国内头部半导体设备厂商建立了高度稳定的战

（下转A14版）